

kupfer\_



Information

## Kupfer in der Drahtfertigung

Aufbauseminar  
26. April 2023 | Düsseldorf

## Programm

### Kupfer in der Drahtfertigung

Mittwoch, 26. April 2023

09:30 Uhr

#### Begrüßung

09:45 Uhr

#### Vom Erz zur Kathode

#### Kupfergewinnung und -verfügbarkeit

Christian Blecking

Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.

10:00 Uhr

#### Von der Kathode zum Gießdraht

#### 4 Gießprozesse der Drahterzeugung

Michael Sander

Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.

- ETP-Cu-Rod:
  - i. Das Southwire-Gießrad-Verfahren
  - ii. Das Hazelett-Bandgieß-Verfahren
- OF-Cu-Rod (sauerstofffrei):
  - i. Das Upcast-Verfahren
  - ii. Das Dip-Forming-Verfahren
- Fehlerpotentiale beim Gießen und Walzen

10:30 Uhr

#### Cu-Draht-Werkstoffe

Dr. Ladji Tikana

Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.

11:00 Uhr

#### Wärmebehandlung von Kupferwerkstoffen

Dr. Ladji Tikana

- Allgemeines
- Glühprozesse
  - iii. Durchlaufglühen
  - iv. Haubenglühen
- Sonstige Verfahren

11:30 Uhr

#### Kaffeepause

11:45 Uhr

#### Vom Gießdraht zum gezogenen Draht:

#### Kupferdrahtzug

Michael Sander

- Das Prinzip des mehrstufigen Ziehprozesse
- Ziehsteine als Ziehwerkzeuge und ihre Instandhaltung
- Fehlerpotentiale beim Drahtziehen
- Prüfverfahren

12:30 Uhr

#### Mittagspause

13:30 Uhr

#### Nachhaltigkeit in der Ziehmaschinenteknik

Stephan Gorgels, Niehoff GmbH. & Co. KG

14:15 Uhr

#### Vom Runddraht zum Flachdraht

#### Der Walzprozess

Michael Sander

14:30 Uhr

#### Vom Blankdraht zum Lackdraht

Michael Sander

- Der Lackierprozess
- Fehlerpotentiale unter Berücksichtigung des Vormaterials

15:15 Uhr

#### Kaffeepause

15:45 Uhr

#### Vom Blankdraht zum verzinnnten Draht

#### Metallische Drahtbeschichtung

Michael Sander

16:05 Uhr

#### Vom Blankdraht zur Litze

#### Verlitz- und Verseilprozesse

Michael Sander

16:45 Uhr

#### Von der Litze zum Kabel

#### Kabel-Extrusion

Michael Sander

17:05 Uhr

#### Diskussion / Individuelle Fragestellungen

17:30 Uhr

#### Ende der Veranstaltung

## Kupfer in der Drahtfertigung

Mittwoch, 26. April 2023

---

### Seminar Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Ingenieure, Techniker und Konstrukteure.

### Dauer

1 Tag

### Anmeldung

Per E-Mail an [technik@kupfer.de](mailto:technik@kupfer.de) oder online über [www.kupfer.de](http://www.kupfer.de).

### Teilnahmegebühr & Leistungen

Die Teilnahmegebühr beträgt 1050,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt. und schließt die Seminarunterlagen, Getränke, Mittagessen und Snacks ein. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung.

### Frühbucherrabatt

Teilnehmer, die bis zum 15.03.2022 buchen, erhalten einen Preisnachlass von 75 €.

### Mitgliederrabatt

Mitarbeiter von Mitgliedsunternehmen erhalten vom ersten Teilnehmer an einen Preisnachlass von 15%.

### Mehrteilnehmerrabatt

Ab dem zweiten Mitarbeiter aus demselben Unternehmen gilt ein Preisnachlass von 10 %.

**Die Rabatte sind nicht kombinierbar, außer es handelt sich um einen Frühbucherrabatt.**

### Rabatt für Hochschulmitarbeiter

Hochschulmitarbeiter erhalten einen Preisnachlass von 10%.

### Rücktritt & Storno

Stornierungen bis zehn Wochen vor Seminarbeginn sind kostenlos; bei Stornierung bis 14 Tage vor Seminarbeginn erheben wir eine Stornogebühr in Höhe von 50 €. Bei späterer Stornierung oder Nichterscheinen des Teilnehmers wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe berechnet. Selbstverständlich ist eine Vertretung durch einen anderen Teilnehmer im Verhinderungsfall jederzeit kostenlos möglich.

### Seminarorganisation

Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.  
Miriam Rehring  
Telefon: +49 211 239469 – 15  
E-Mail: [Miriam.rehring@kupfer.de](mailto:Miriam.rehring@kupfer.de)

### Veranstaltungsort

INNSIDE Düsseldorf Seestern  
Niederkasseler Lohweg 18a  
40547 Düsseldorf

**Es besteht ein Abrufkontingent an Zimmern zum Preis von 119 € inkl. Frühstück, buchbar bis zum 15.03.2023 unter dem Stichwort „Kupferverband“.**

### Bitte beachten Sie

Wir behalten uns vor, das Präsenz-Seminar aufgrund von aktuell bestehenden Corona-Verordnungen als Web-Seminar durchzuführen.